

S-PIMA

••••• MICRODISPENSING



执行高粘度至超高粘度流体应用

- 快速的顶端校正配置
- 高速压电技术
- 精准可重复的喷射点胶结果
- 超精准的非接触式喷射点胶
- 超广泛的应用领域

PRECISION DOTS



焊锡膏



硅胶

高粘度喷射点胶系统

- 高速喷射点胶阀SAC3250+系列配置高效能的压电驱动器
- 超高的撞针升程和力度使其尤其适合喷射高粘度流体

高效的压电技术

- 高速压电技术有限缩短点胶循环
- 阀门快速开启/闭合

快速的顶端校正配置

- 最新顶端校正设计有效缩短撞针和喷嘴校正时间

可重复的喷射点胶结果

- 系统可完成高度一致的单点（最小0.8纳升）或珠状体的点胶作业
- 误差值（CV）低至1%

成本节约

- 撞针，喷嘴及全新和旧款配件自由选配，利于成本节约
- 模块化阀体设计区分湿区和干区，使更换湿区部件快速且安全，从而节省维护成本
- 简便快速的配件清洗和更换流程有效地缩短停工时间

超精准的非接触式喷射点胶

- 超精准的非接触式流体喷射点胶设计满足广泛的流体粘度区间（最高可达200万MPAS
- 一贯的轻量化设计使胶点精度最大化

阀体内存扩展

- 与SAC3200A相比，SAC3250+拥有其4倍的内存空间
- SAP3250+提供多种应用相关信息存储

全兼容

- 该阀体与斯匹马全系列液盒相兼容
- 同样适配于早期的XY轴点胶系统

选择引脚/方案模式

- 选择引脚和方案模式可随时在点胶过程中更改胶点尺寸和点胶速度
- 可编程的方案模式适用于几乎所有应用要求

超广泛应用领域

- 模块化设计使SAC3250+系列适用于广泛的用户定义应用
- 用户定制化连接线设计减少对空间要求

推荐流体	SMT胶黏剂（涵盖含有硬质颗粒的导电粘剂硅树脂，LED荧光粉，底部填充剂，热熔胶，锡膏等	
撞针类型	可更换，不同形状，单片陶瓷或碳化金属	
点胶量	最小0.8纳升单点（取决于流体类型）	
最小胶点直径	170微米	
供压	0.1-8bar(rel.)，最高100BAR	
点胶压力	1-1000bar可调	
频率	取决于应用和流体介质，频率可高达3000HZ	
额外功能	实时动作： 方案模式→预编程胶量变化 选择引脚→手动控制胶量变化	
阀运行模式	脉冲模式：按下触发键后执行预定义脉冲 单点模式：取决于路径长度的点胶 无限模式：喷射点数由外部信号触发 外部模式：由应用控制定义的点胶量	
可选加热系统	可控的喷嘴加热：180°C(更高温度可依要求实现)	
标准接口	RS-232C;24V/5V PLC,AUX	
电源连接	110/230v AC,50/60 hz 电源连接（背面）	
点胶参数内存	内置:10；外置:无限	
相关尺寸	阀体 SAC 3250+ 92.1mm(H)x41.5mm(W)x36.5(D) (包含空气冷却)	控制器 SAP 3250 128mm(H)x102mm(W)x173mm(D) (CP紧)（不含线材）
重量	阀体:250g, 控制器:1350g	